

主催 レーザ協会 第 196 回研究会
レーザ加工にできること
～切る・積む・表面機能～

日時: 令和 5 年 5 月 24 日 (水) 14:30～17:10

会場: 中央大学理工学部後楽園キャンパス 6 号館 3F 6302 号室
(文京区春日 1-13-27、最寄り駅: 後楽園駅、春日駅、水道橋駅)

開催形式: 対面開催



研究会主旨: 総会後に 196 回研究会を開催します。「レーザ加工にできること ～切る・積む・表面機能～」と題し、最新の技術動向について 3 件の話題を提供致します。まず「切る」では、東京精密(株)のレーザダイシング装置および加工技術を詳しくご紹介頂きます。次に「積む」では、愛知産業(株)の金属積層造形について、ドイツの最新情報も含め詳しくご紹介頂きます。最後に、先進的な研究で知られる慶應義塾大学閻教授から、レーザ微細加工で発現する表面機能について、興味深いお話を伺います。万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

司会: レーザ協会副会長 (産総研) 加納誠介氏

14:30～14:35 **開会挨拶** レーザ協会 池野 順一会長 (埼玉大学)

14:35～15:25 **講演1**

「レーザダイシング装置について」

東京精密(株) 相川 力氏

15:25～16:15 **講演2**

「金属 3D プリンタの最新技術動向」

愛知産業株式会社 木寺 正晃氏

16:15～17:05 **講演3**

「レーザ微細加工による各種材料の表面機能発現」

慶應義塾大学 閻 紀旺氏

17:05～17:10 **閉会挨拶**

レーザ協会 徳永 剛副会長 (千葉工業大学)

【参加費】 会員: 無料 非会員: 4,000 円 (当日お支払い下さい)

協賛専門委員会会員: 3,000 円 (当日お支払い下さい)

【申込先】 レーザ協会ウェブページ <http://jslt.jp/> の申込みフォームよりお申し込み下さい。

・参加申込〆切: 令和 5 年 5 月 17 日 (水) 17 時

【問合せ先】 レーザ協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp